(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
Bureau international

(43) Date de la publication internationale
10 novembre 2005 (10.11.2005)

PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 2005/106948 A1

(51) Classification internationale des brevets[7] : H01L 21/78, 21/68

(21) Numéro de la demande internationale : PCT/FR2005/001021

(22) Date de dépôt international : 25 avril 2005 (25.04.2005)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
0404437 27 avril 2004 (27.04.2004) FR

(71) Déposant *(pour tous les États désignés sauf US)* : **S.O.I.TEC SILICON ON INSULATOR TECHNOLOGIES** [FR/FR]; Parc Technologique des Fontaines, Chemin des Franques, F-38190 Bernin (FR).

(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants *(pour US seulement)* : **GHYSELEN, Bruno** [FR/FR]; 58, rue Georges Maeder, F-38170 Seyssinet (FR). **RAYSSAC, Olivier** [FR/FR]; 7, chemin du Chapitre, F-38100 Grenoble (FR).

(74) Mandataires : **MARTIN, Jean-Jacques** etc.; Cabinet Regimbeau, 20, rue de Chazelles, F-75847 Paris Cédex 17 (FR).

(81) États désignés *(sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible)* : AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) États désignés *(sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible)* : ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

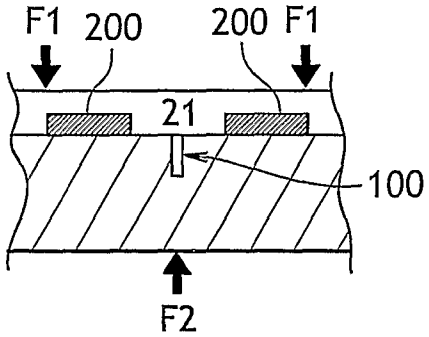
Déclaration en vertu de la règle 4.17 :
— *relative à la qualité d'inventeur (règle 4.17.iv)) pour US seulement*

Publiée :
— *avec rapport de recherche internationale*
— *avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues*

[Suite sur la page suivante]

(54) **Title:** METHOD FOR MAKING CHIPS AND ASSOCIATED SUPPORT

(54) **Titre :** PROCEDE DE FABRICATION DE PUCES ET SUPPORT ASSOCIE



(57) **Abstract:** The invention concerns a method for making a plurality of chips, each chip comprising at least one circuit, the method comprising the following successive steps: creating the chips on a semiconductor material layer, said layer being integral with a substrate; transferring said layer comprising the chips of the substrate onto a support; forming individual chips by cutting out said layer according to a predetermined cutting pattern. The invention is characterized in that the method further comprises, prior to transferring the layer onto the support, forming on the support a weakening pattern corresponding to the cutting pattern. The invention also concerns a method for making an associated support, and said support.

(57) **Abrégé :** L'invention concerne un procédé de fabrication d'une pluralité de puces, chaque puce comportant au moins un circuit, le procédé comportant la succession des étapes suivantes : Création des puces sur une couche de matériau semiconducteur, ladite couche étant solidaire d'un substrat, transfert de ladite couche comportant les puces du substrat sur un support, constitution de puces individuelles par le découpage de ladite couche selon un motif de découpage prédéterminé, caractérisé en ce que le procédé comporte également, avant le transfert de la couche sur le support, la constitution sur le support d'un motif de fragilisation correspondant au motif de découpage. L'invention concerne également un procédé de fabrication d'un support associé, et un tel support.

WO 2005/106948 A1

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.